



**Toshiba stellt 40V-Automotive-MOSFETs mit niedrigem Rds(on)  
in 5 mm x 6 mm Gehäusen mit doppelseitiger Kühlung vor**

*Neues Gehäuse verbessert das Wärmeverhalten*

**Düsseldorf, 4. September 2018** – Toshiba Electronics Europe stellt mit dem TPWR7904PB und TPW1R104PB zwei 40V-n-Kanal-Leistungs-MOSFETs im DSOP Advance (WF) Gehäuse vor, das eine beidseitige Kühlung ermöglicht. Der TPWR7904PB ist ein 40V-MOSFET mit maximal 0,79mΩ Rds(on) im DSOP Advance (WF)L Gehäuse. Der TPW1R104PB ist ein 40V-MOSFET mit maximal 1,14mΩ Rds(on) im DSOP Advance (WF)M Gehäuse. Beide Bausteine basieren auf dem neuesten U-MOSIX-H-Trench-Prozess und sind AEC-Q101-qualifiziert. Sie zielen auf Anwendungen in Fahrzeugen ab, wie z.B. elektrische Servolenkungen (EPS), Lastschalter und elektrische Pumpen.

Sowohl das DSOP Advance (WF)M als auch das DSOP Advance (WF)L sind 5 mm x 6 mm Gehäuse mit acht Pins. Sie unterscheiden sich in der Größe ihrer freiliegenden Metalloberfläche. Diese beträgt etwa 8 mm<sup>2</sup> beim DSOP Advance (WF)M und etwa 12 mm<sup>2</sup> beim DSOP Advance (WF)L. Messungen in Toshibas Testumgebung ergaben eine maximale Wärme-Impedanz zwischen Kanal und Metalloberfläche von 1,5K/W für den TPW1R104PB und 0,93 K/W für den TPWR7904PB. Dieses hervorragende Wärmeverhalten wird durch die Befestigung der freiliegenden Oberfläche über eine isolierende Schicht an einen Kühlkörper (z.B. ein Metallrahmen) möglich.

Das DSOP Advance (WF)M und DSOP Advance (WF)L weisen die gleiche Stellfläche wie ein SOP Advance (WF) Gehäuse auf, das keine freiliegende Metalloberfläche aufweist. Sie bieten benetzbare Anschlüsse, die eine automatische optische Inspektion (AOI) von Lötstellen auf Leiterplatten ermöglichen. AOI ist insbesondere in Automotive-Anwendungen wichtig, bei denen eine Überprüfung der Lötqualität erforderlich ist.

Die Serienfertigung des TPWR7940PB und TPW1R104PB hat im August 2018 begonnen.

###

**Über Toshiba Electronics Europe**

[Toshiba Electronics Europe GmbH](#) (TEE) ist der europäische Geschäftszweig für elektronische Komponenten [Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation](#). TEE bietet europäischen Kunden und Unternehmen eine umfangreiche, innovative Auswahl an Hard Disk Drives (HDD) sowie Halbleiter Lösungen für Automotive, Industrie IoT, Motor Control, Telekommunikation und Netzwerktechnik oder für Endverbraucher- und Haushaltsgeräte-Applikationen. Das Produktsortiment des Unternehmens umfasst integrierte Wireless ICs, Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, optische Halbleiter, ASICs, ASSPs und diskrete Komponenten, von Dioden bis hin zu Logic-ICs.

Zum Hauptsitz in Düsseldorf gehören Zweigstellen in Frankreich, Italien, Schweden, Spanien und Großbritannien. Von dort aus werden Design, Marketing und Vertrieb bereitgestellt. Präsident des Unternehmens ist Mr. Tomoaki Kumagai

Weitere Informationen über Toshiba Electronics Europe unter: [www.toshiba.semicon-storage.com](http://www.toshiba.semicon-storage.com).

**Ansprechpartner für Veröffentlichungen:**

Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Deutschland

Tel: +49 (0) 211 5296 0 Fax: +49 (0) 211 5296 79197

Web: [www.toshiba.semicon-storage.com/eu/company/news.html](http://www.toshiba.semicon-storage.com/eu/company/news.html)

E-mail: [discrete-ic@toshiba-components.com](mailto:discrete-ic@toshiba-components.com)

**Ansprechpartner für die Presse:**

Michelle Shrimpton, Toshiba Electronics Europe GmbH

Tel: +44 (0)193 282 2832

E-mail: [MShrimpton@teu.toshiba.de](mailto:MShrimpton@teu.toshiba.de)

**Herausgegeben durch:**

Birgit Schöniger, Publitek

Tel: +44 (0) 20 8429 6554

Web: [www.publitek.com](http://www.publitek.com)

E-mail: [birgit.schoeniger@publitek.com](mailto:birgit.schoeniger@publitek.com)